

エポキシ樹脂系ソルダペースト

Solder paste with epoxy resin based flux

エポキシ樹脂硬化によりはんだ接合部を補強

Reinforces solder joints by curing epoxy resin

エポキシ樹脂による残渣固着により、レンズ等光学部品の汚染防止

Adhering residue by epoxy resin prevents contamination of optical components such as lenses in camera modules.

SAC305組成、Sn-58Bi 組成共に印刷、ディスペンス塗布対応可能

Both SAC305 and Sn-58Bi compositions are available for printing and dispensing.

NP303-EPP101-T4 (印刷用)
For printing

NP303-EPC101-T4 (ディスペンス用)
For dispensing

※TYPE6 にも対応可能 Type 6 is available

SB58-EPP101-T4 (印刷用)
For printing

SB58-EPC101-T4 (ディスペンス用)
For dispensing

ぬれ拡がり比較

Comparison of wettability

	従来品 Conventional product	NP303-EPP101-T4
大気リフロー general air reflow	 ふちにはじきが発生 Non wetting confirmed at edge	 ぬれ拡がり良好 Well wetting
N2 リフロー 酸素濃度 1000ppm N2 Reflow O ² control:1000ppm	 ふちにはじきが発生 Non wetting confirmed at edge	 ぬれ拡がり良好 Well wetting

ボイド観察~QFN 部品実装による確認 (Type6 適用事例)~

Observation of Void at QFN component mounting (at the case of Type6 applied)

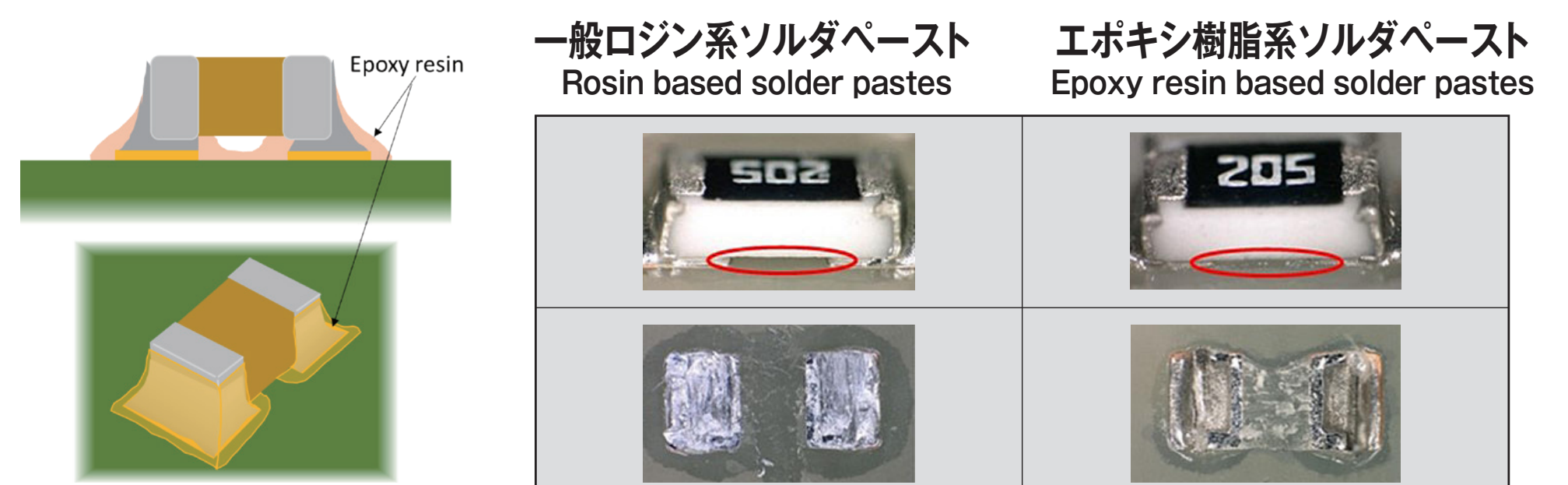
従来品 Conventional product	NP303-EPP101-T6	
ボイド率: 33.94% Void rate:33.94%	ボイド率: 12.88% Void rate:12.88%	ボイド率: 12.3% Void rate:12.3%

フラックス成分の流動性が良い為、
フラックス成分が接合部に残らず、ボイドを抑制

The excellent fluidity of flux does not remain that in the joint and suppresses void.

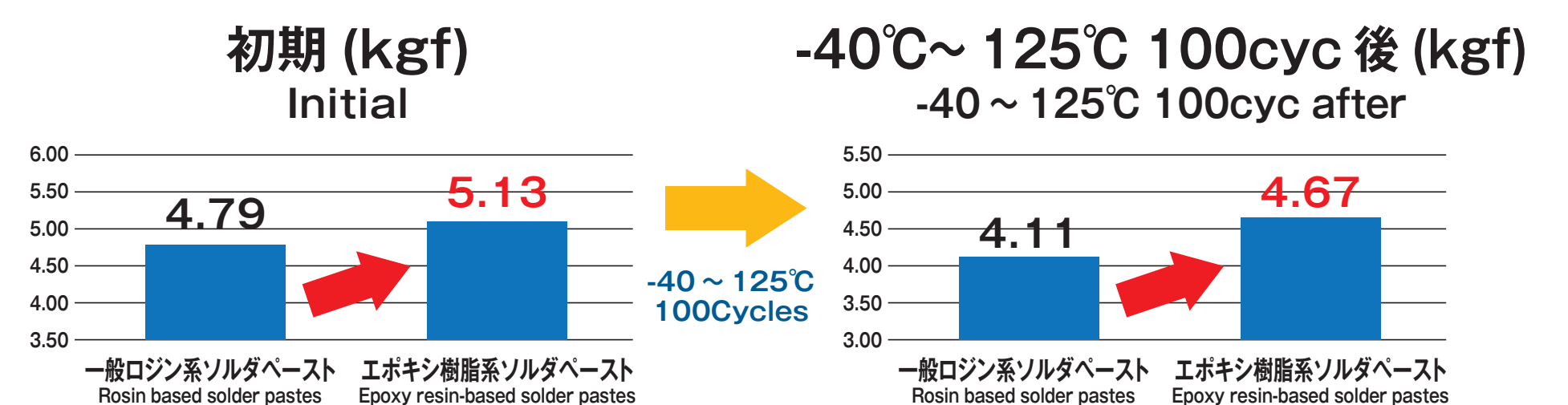
エポキシ樹脂硬化によるはんだ接合部

Solder joints by epoxy resin curing



リフロー後のシア強度測定結果 (0603 チップ部品)

Shear strength after reflow (0603 chip component)

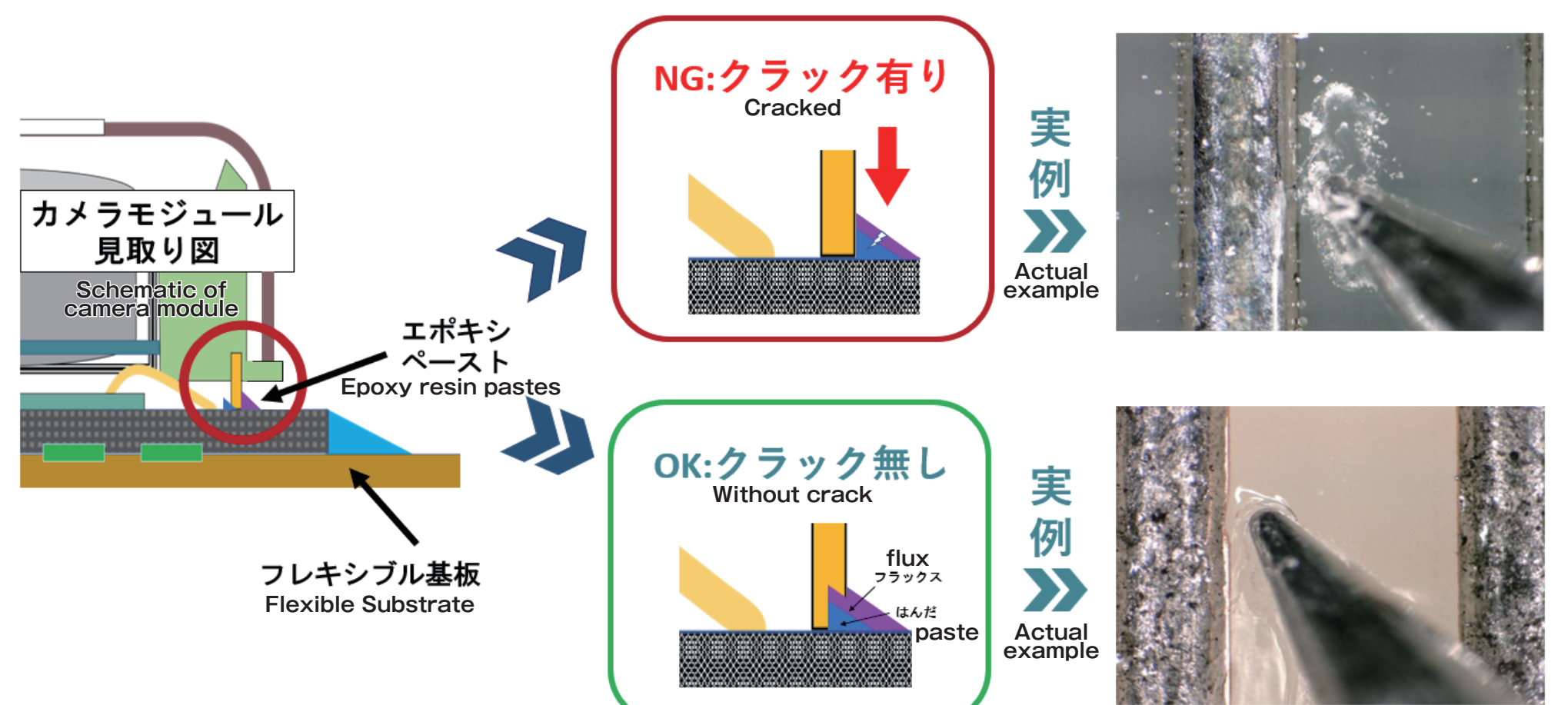


従来のロジン系ソルダペーストに比べ、シア強度が高く、
冷熱衝撃試験後の劣化が少ない

Higher shear strength and less degradation after thermal shock testing compared to conventional rosin-based solder pastes

リフロー後のフラックス残渣比較

Comparison of flux residue after reflow



エポキシ樹脂による残渣固着により、レンズ等光学部品の汚染防止

Adhering residue by epoxy resin prevent contamination of lense and other optical comonents

